

特别评论

2026 年 10 月

中国半导体行业中期信用观察：AI 驱动
行业景气上行，内部结构分化显著

核心观点

- 受产业政策与资金大力支持、外部限制措施持续收紧、下游需求扩张三重因素驱动，2026 年上半年国内半导体设备与材料国产替代进程明显加速，从单点突破阶段迈入全链条协同推进阶段。半导体设备和材料替代品类持续拓宽升级，并逐步走向批量供货阶段，但高端核心设备与前沿材料领域仍与海外主流厂商存在较大差距。国产替代进程加速推进有利于提升我国半导体产业链安全韧性与扩产自主性，也为国内设备和材料企业打开了广阔成长空间，但随着行业向高端纵深领域推进，仍需警惕技术落地不及预期、资产折旧高企以及市场竞争激烈等因素对企业经营造成的阶段性压力。
- 在大模型技术迭代与 AI 规模化应用落地的双轮驱动下，2026 年以来全球算力需求快速增长，科技巨头、云厂商及运营商持续加码算力基础设施建设投入，国产 AI 芯片与存储芯片成为核心受益领域。海外出口管制倒逼国内产业进行自主创新，叠加算力内需持续扩容，国产 AI 芯片依托多条技术路线实现突破，与海外产品的性能差距持续收窄，但先进制程能力及配套软件生态差距仍较大。同时，AI 拉动存储芯片需求快速攀升，全球市场供需偏紧，推动存储价格出现历史级上涨，在加速国产存储导入及上游设备材料本土化替代的同时抬升中下游制造成本，未来需警惕新增产能集中释放后存储价格大幅下跌的周期性风险。
- 2026 年上半年，半导体下游需求呈现显著的结构分化，AI 相关品类量价齐升，成为行业增长核心引擎，大模型迭代与智能体应用落地推动 AI 芯片、HBM、光模块等全线涨价，核心企业业绩大幅增长；汽车电子受益于新能源汽车渗透率提升和单车芯片价值量增长，车规级半导体需求稳步上行；工控领域在制造业自动化升级、AI 算力基建、光伏储能及国产替代等多重因素支撑下保持韧性增长。相比之下，传统消费电子仍处于复苏调整阶段，存储涨价推高终端整机成本，叠加产品创新乏力、用户换机周期拉长等因素，智能手机和 PC 出货量均同比下滑，部分消费电子芯片企业业绩承压明显。
- 2026 年上半年，样本半导体企业整体营业收入和净利润均实现同比高速增长，毛利率显著抬升，但受下游需求结构性分化影响，行业内部分化显著，呈现典型的结构性高景气特征。行业资产质量总体向好，资本开支扩张节奏温和，财务杠杆水平有所下降，经营活动现金流有所好转，造血能力显著增强。随着科创债政策红利持续释放，样本企业债券发行提速，偿债指标表现有所改善。

目录

核心观点	1
半导体产业链格局与变化	2
样本企业信用分析	5
结论	8

联络人

作者

企业评级部

杨锐 027-87339288-288

ryang@ccxi.com.cn

毛楚杰 027-87339288-211

chjmao@ccxi.com.cn

其他联络人

贺文俊 010-66428877

wjhe@ccxi.com.cn

半导体行业产业链条长、细分领域众多，涉及国民经济诸多重点领域，是支撑数字经济与高端制造发展的战略性、基础性、先导性产业。2026年上半年，受AI算力基础设施建设集中释放带动，行业呈现结构性高景气特征。本文剖析了2026年上半年半导体行业的主要运行变化，并根据样本企业财务数据，从盈利表现、资产质量、现金流及偿债能力等维度，分析行业整体信用特征。

一、半导体产业链格局与变化

1、设备与材料国产替代加速推进

受产业政策与资金大力支持、外部限制措施持续收紧、下游需求扩张三重因素驱动，2026年上半年国内半导体设备与材料国产替代进程明显加速，从单点突破阶段迈入全链条协同推进阶段。半导体设备和材料替代品类持续拓宽升级，并逐步走向批量供货阶段，但高端核心设备与前沿材料领域仍与海外主流厂商存在较大差距。国产替代进程加速推进有利于提升我国半导体产业链安全韧性与扩产自主性，也为国内设备和材料企业打开了广阔成长空间，但随着行业向高端纵深领域推进，仍需警惕技术落地不及预期、资产折旧高企以及市场竞争激烈等因素对企业经营造成的阶段性压力。

2026年上半年，半导体设备与材料国产替代进程明显加速，已从“单点突破”阶段向“全链条协同”阶段跃升，其核心驱动主要来自三个方面：一是产业政策与资金强力支持，我国中央与地方已构建涵盖顶层规划、产业基金、税收优惠及算力基建等多维度协同的产业扶持体系¹，持续推动产业链向自主可控与高端化转型，其中2025年下半年至2026年上半年，国家集成电路产业投资基金三期重点向设备、材料、先进封装等产业链上游薄弱环节倾斜，并布局AI互联芯片、存算一体芯片等前沿算力赛道，约70%资金投向上游设备与材料国产化，约30%投向先进封装、HBM、AI算力等前沿方向，进一步夯实产业链自主可控基础，引导国内半导体产业向高端化、差异化升级。二是外部限制措施持续收紧，美国、韩国、欧盟以出口管制、关税、实体清单等方式持续收紧对华半导体供给²，倒逼国内晶圆厂加速验证国产设备与材料供应链，国产化从“可选项”变为“必选项”。三是下游需求扩张提供验证场景，2026年国内晶圆厂成熟制程扩产节奏加快，中芯国际、华虹公司、长江存储、长鑫存储等头部厂商资本开支持续处于高位，为国产设备材料提供了大量验证和导入机会。

在上述多重因素的共同推动下，国产半导体设备率先进入收获期，国产替代品类不断拓宽、渗透率持续提升，从刻蚀、清洗等“相对成熟”的品类，向薄膜沉积、离子注入、涂胶显影、CMP、测试设备、先进封装设备等“攻坚中”的品类延伸，但在高端设备领域与海外龙头厂商仍存在显著差距。国产化程度较高的板块主要包括刻蚀设备和清洗设备，但先进制程领域的部分高端型号仍依赖进口，其中代表性企业中微公司的CCP刻蚀设备已在3nm及更先进的芯片生产线上实现了批量销售，盛美上海、芯源微等企业凭借成熟度较高的清洗设备技术已在国内多条产线完成验证并实现规模化导入；国产化程度中等的板块主要包括薄膜沉积设备和测试设备，其中拓荆科技的PECVD、ALD设备在国内主流晶圆厂实现批量交付，华峰测控、长川科技在模拟测试、分选机等领域持续突破，整体国产化率有望持续提升；国产化程度较低的板块主要包括光刻机和涂胶显影设备，其中国产DUV光刻机已进入产线验证阶段，但产能、精度和良率与海外巨头差距明显，且EUV光刻机领域尚未实现产业化突破，涂胶显影设备代表性企业芯源微已实现从后道先进封装向晶圆前道的跨越，打破了海外厂商长期垄断格局，并持续获得国

¹ 2026年以来中国半导体行业国内主要政策梳理详见附表一。

² 2026年以来各国对中国半导体行业主要限制措施详见附表二。

内头部逻辑、存储、功率客户的订单，但国产化程度仍然极低。整体来看，成熟制程产线的设备国产化率已突破50%，但先进制程产线设备仍处于加速验证追赶阶段。此外，**半导体材料**的国产替代进程也在同步深化，整体呈现从成熟品类向高端品类、从实验室验证到批量供货的递进态势，但部分高端产品的国产化替代仍有较大空间。国产化程度相对较高的板块主要为湿电子化学品，江化微、安集科技、格林达等代表性企业在G5级高端产品上不断突破，目前通用产品国产化率已过半，国产突破重点正由高纯化向配方化、先进制程认证延伸。国产化程度中等的板块主要包括硅片、G/I线光刻胶、电子特气和靶材，其中沪硅产业、立昂微、中环领先等企业12英寸硅片产能持续释放，国产化率进一步提升，但在高端领域的市场占有率仍处于极低水平；彤程新材、晶瑞电材、上海新阳等企业在G线、I线光刻胶领域已实现批量供货；华特气体、金宏气体、雅克科技等企业的电气特气品种覆盖度持续提升，未来高端光刻气、先进刻蚀气及部分稀有气体仍是重点替代方向；江丰电子、有研新材等企业在12英寸高纯溅射靶材领域已实现批量供应。国产化程度较低的板块主要为KrF、ArF及EUV光刻胶，目前高端产品仍由日本头部厂商主导，国内厂商的市场占有率仍存在较大提升空间。

整体来看，国产替代的加速推进，不仅改变了现有产业链的供应格局，也对上下游企业的经营质量产生了深远影响。对晶圆厂而言，设备材料国产化有效降低了供应链断供风险，同时在一定程度上降低了采购成本，增强了扩产的自主性和可控性，但短期内也面临着国产设备良率爬坡、材料一致性验证等过渡性挑战。对设备材料企业而言，国产替代打开了巨大的成长空间，头部企业凭借先发优势和技术积累，订单和收入持续快速增长，但大量中小型企业仍面临研发投入大、客户验证周期长、盈利尚未兑现等压力。随着国产替代进程推进，未来半导体设备和材料将继续向先进制程、高端量测、核心材料等关键领域纵深推进，板块内相关企业受益于下游扩产配套需求与国产化渗透率提升的双重红利，经营业绩有望持续增长，但仍需警惕技术研发落地不及预期、资产折旧摊销压力较大以及成熟赛道市场竞争不断加剧等因素对企业盈利空间造成的阶段性压力。

2、算力基建加速扩容，AI与存储芯片供需共振

在大模型技术迭代与AI规模化应用落地的双轮驱动下，2026年以来全球算力需求快速增长，科技巨头、云厂商及运营商持续加码算力基础设施建设投入，国产AI芯片与存储芯片成为核心受益领域。海外出口管制倒逼国内产业进行自主创新，叠加算力内需持续扩容，国产AI芯片依托多条技术路线实现突破，与海外产品的性能差距持续收窄，但先进制程能力及配套软件生态差距仍较大。同时，AI拉动存储芯片需求快速攀升，全球市场供需偏紧，推动存储价格出现历史级上涨，在加速国产存储导入及上游设备材料本土化替代的同时抬升中下游制造成本，未来需警惕新增产能集中释放后存储价格大幅下跌的周期性风险。

2026年以来，在大模型技术持续迭代升级和市场需求扩容的双向驱动下，各行各业AI落地渗透进程不断提速，叠加多模态、智能体等创新应用场景快速拓展，全球训练与推理算力需求爆发式增长，对算力基础设施形成持续刚性拉动。在需求快速扩张的推动下，科技巨头、云厂商及运营商等企业基于长期竞争战略考虑，纷纷加大算力资源投入，同时各国将AI算力视为数字经济核心竞争力，相继出台算力支持政策和产业引导措施，进一步加速算力基础设施的布局节奏。国内方面，三大运营商持续加码算力领域投资，2026年上半年算力相关资本开支规模及占比均实现快速增长。2026年上半年，中国移动算力网投资规模156亿元，同比增长71.3%，智能网投资规模37亿元，同比增长85.2%；中国电信整体资本开支规模324亿元，其中算力网投资规模同比增长97%，占比同比提升24.6个百分点；中国联通整体资本开支规模241亿元，其中算力投资占比提升至37%，投资额同比增幅超过80%。互联网巨头方面，2026年上半年阿里巴巴资本开支规模合计约1,064亿元，同比大幅增长，主要系其持续投入AI基础设

施建设以满足不断增长的客户需求；腾讯资本开支规模847.20亿元，同比增长82%，主要投向数据中心、服务器等AI基础设施；字节跳动将2026年AI基础设施资本支出预算上调至2,000亿元；叠加华为、百度等头部科技企业的密集投入，国内AI算力需求呈现井喷态势。海外方面，微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达等五大科技巨头2026年合计资本开支超过7,000亿美元，绝大部分投向AI算力基础设施。

在全球算力基础设施投资持续扩张的背景下，国产AI算力芯片与存储芯片成为核心受益领域。首先，海外持续收紧对华先进AI芯片出口管制，为国产芯片创造了替代市场空间，而国内大模型训练和推理需求的快速增长，则提供了规模化落地的真实应用场景。当前国产AI芯片已形成多路线并行突破的发展格局，其中华为昇腾依托全栈软硬件生态及910、950等系列芯片产品占据国内AI算力市场的主导地位，寒武纪、海光信息、燧原科技等企业亦在各类应用场景实现规模化落地，整体产品性能与海外高端产品的差距逐步缩小，但在先进制程工艺、软件生态成熟度等方面仍有较大进步空间。未来随着实战应用中不断迭代升级，国产AI芯片将朝着更高算力密度、更完备软件生态、更丰富应用场景演进，在持续迭代硬件架构、追赶国际先进硬件水平的同时，加速算子库、编译器、大模型框架适配等软件生态的建设。

其次，由于AI大模型和智能体应用对大容量、高带宽数据存取的刚性要求，算力侧的增长效应沿AI系统架构向存储环节传导，推动存储芯片需求迎来指数级增长。然而全球存储供给市场呈现高度集中的寡头格局，三星、SK海力士、美光三大厂商合计占据全球DRAM市场约90%和NAND市场约60%的市场份额，国内长江存储、长鑫存储近年来快速崛起但整体占比仍较低。尽管2026年各大厂商纷纷上调资本开支规模，积极推进扩产计划，但HBM良率偏低、产能爬坡周期长、上游设备交期延长等因素制约了供给释放节奏，且厂商扩产资源普遍优先向HBM倾斜，挤占了传统DRAM和NAND产能，供需错配下2026年存储芯片价格出现历史罕见的暴涨。2026年一季度DRAM合约价环比上涨90%~95%，NAND Flash合约价环比上涨55%~60%；二季度DRAM合约价继续环比上涨58%~63%，NAND Flash合约价环比上涨70%~75%，HBM3E现货价高达约2,100美元，为长期协议价的4~5倍。存储芯片供不应求的市场格局对我国半导体产业链带来多重影响：一方面，存储价格暴涨在一定程度上加速了国产存储的验证和导入进程，长江存储、长鑫存储迎来加速发展的窗口期，存储厂商盈利水平得到显著改善，成为行业利润增长的核心来源，并且持续加码的资本开支也将带动上游设备、材料环节的国产替代进程提速；另一方面，AI芯片厂商和服务器厂商面临存储成本上行压力，并通过产品涨价向下游传导，HBM供给紧缺更是成为制约AI算力供给的关键瓶颈，部分中小客户受供货限制被迫推迟算力部署节奏。此外，未来随着新增产能的集中释放，需警惕供给过剩导致存储价格大幅下跌的周期性风险。

3、终端需求显著分化，AI赛道与传统消费冰火两重天

2026年上半年，半导体下游需求呈现显著的结构化分化，AI相关品类量价齐升，成为行业增长核心引擎，大模型迭代与智能体应用落地推动AI芯片、HBM、光模块等全线涨价，核心企业业绩大幅增长；汽车电子受益于新能源汽车渗透率提升和单车芯片价值量增长，车规级半导体需求稳步上行；工控领域在制造业自动化升级、AI算力基建、光伏储能及国产替代等多重因素支撑下保持韧性增长。相比之下，传统消费电子仍处于复苏调整阶段，存储涨价推高终端整机成本，叠加产品创新乏力、用户换机周期拉长等因素，智能手机和PC出货量均同比下滑，部分消费电子芯片企业业绩承压明显。

2026年上半年，半导体下游需求呈现显著的结构化分化特征，AI相关品类量价齐升，成为行业增长的核心驱

动力，汽车与工业控制领域保持稳健增长，而传统消费电子市场仍处于复苏调整阶段。AI产业链方面，大模型技术迭代、智能体应用落地与AI算力基础设施建设形成正向循环，推动AI芯片、HBM、光模块、AI服务器等相关品类需求与价格同步攀升，核心企业业绩大幅增长。2026年上半年，海光信息营收同比增长66.52%，寒武纪营收同比增长108.13%，中际旭创营收同比增长182.49%。此外，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球存储器市场预计同比增长约250%，市场规模将超过8,000亿美元，逻辑芯片预计同比增长37%；TrendForce集邦咨询亦上调预期，在AI基建旺盛需求支撑下，全年AI服务器出货增速上调至近31%。展望全年，预计2026年AI相关品类有望延续量价齐升态势，核心企业营收规模将再创新高。

汽车电子方面，车载电子涵盖车用功率半导体、传感器、计算芯片、智能驾驶、智能座舱及动力控制系统等多类元器件，新能源汽车单车芯片价值量为传统燃油车的2~3倍，在汽车电动化、智能化趋势驱动下，车规级芯片需求稳步上行。根据中汽协数据，2026年上半年我国新能源汽车产销量分别达743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%，新能源汽车新车销量达汽车新车总销量的49.6%，带动车规级MCU、功率半导体、模拟芯片需求稳步增长，时代电气等头部车规级IGBT企业受益于新能源汽车持续放量，出货规模稳步增长。工业控制领域同样展现出较强的发展韧性，工业自动化与智能化升级持续拉动工业半导体需求。据MIR睿工业统计，我国工业自动化行业市场规模整体呈小幅增长态势，2018~2025年由2,500亿元增至2,831亿元。2026年上半年，受益于制造业自动化升级持续推进、AI算力基建带动电源与温控类需求增长、光伏储能等新能源产业扩张以及国产替代进程加快等多重因素，工业级半导体需求保持稳健增长态势，斯达半导等工控及电源领域核心供应商业绩持续向好，营收规模稳步增长。然而，消费电子领域仍处于复苏调整阶段，受存储芯片价格大幅上涨影响，终端整机成本同比增加，厂商通过涨价或降配转嫁成本压力，一定程度抑制了消费者换机需求，叠加消费电子创新乏力、竞争激烈、换机周期延长等因素，终端产品销量有所下滑，韦尔股份、卓胜微等消费电子芯片企业业绩承压明显。据IDC数据统计，2026年第二季度全球智能手机出货量为2.775亿部，同比下降6.7%，中国智能手机市场出货量约为6,601万台，同比下降4.3%，已连续五个季度出现同比下滑；全球PC出货量第二季度同比下降4.9%，为连续九个季度增长后的首次下滑。

二、样本企业信用分析

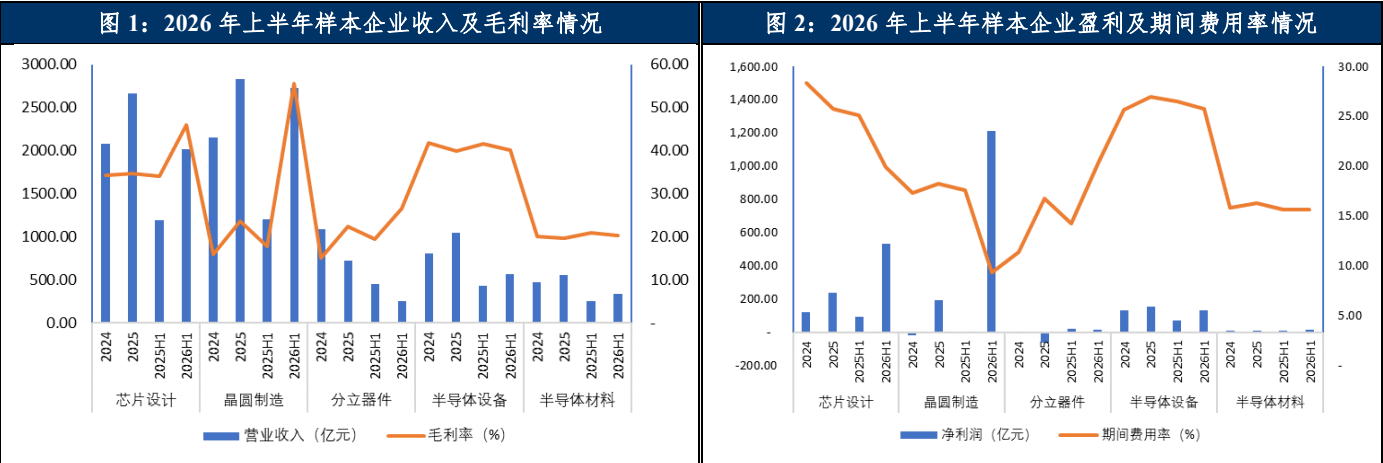
2026年上半年，样本半导体企业整体营业收入和净利润均实现同比高速增长，毛利率显著抬升，但受下游需求结构性分化影响，行业内部分化显著，呈现典型的结构性高景气特征。行业资产质量总体向好，资本开支扩张节奏温和，财务杠杆水平有所下降，经营活动现金流有所好转，造血能力显著增强。随着科创债政策红利持续释放，样本企业债券发行提速，偿债指标表现有所改善。

中诚信国际选取半导体行业A股上市公司作为样本企业，共计186家。从三级行业分类来看，集成电路企业112家（其中芯片设计90家、晶圆制造22家³）、分立器件企业18家、半导体设备企业27家、半导体材料企业29家，不同细分领域的样本企业在财务表现方面存在差异。

收入和盈利方面，2026年上半年，样本半导体企业合计实现营业收入5,900.08亿元、净利润1,918.95亿元，同比

³ 22家晶圆制造企业中包含14家封测企业。

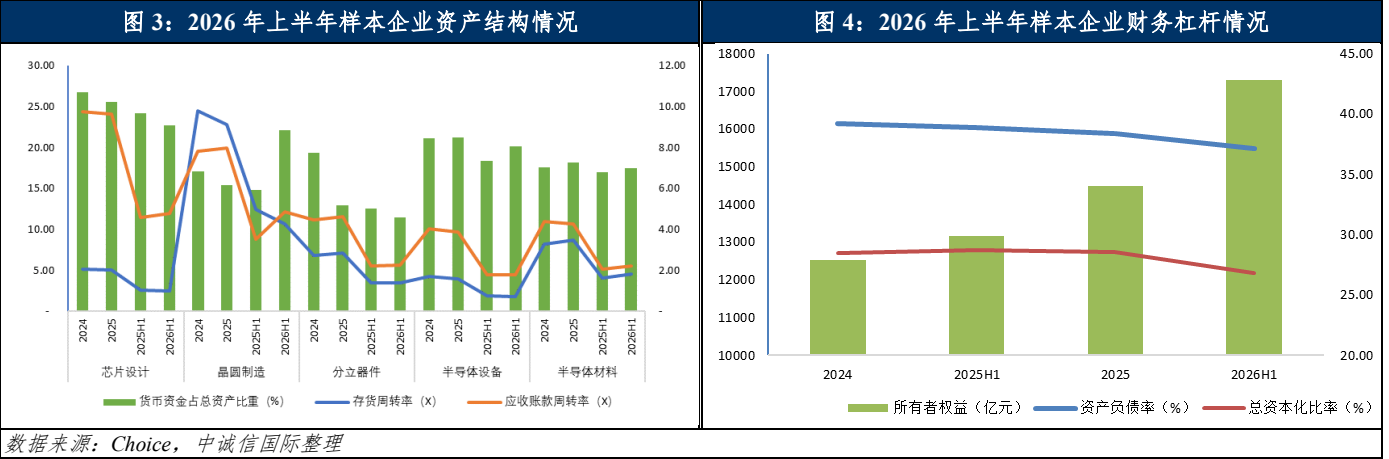
分别增长67.52%和852.02%，平均毛利率由2025年29.15%提升至47.50%，盈利能力大幅提升，但行业内部分化较为突出，呈现典型的结构性高景气特征。分板块来看，2026年上半年，**半导体设备和半导体材料板块**延续国产替代主线，成熟制程设备的国产化率持续提升，多个细分品类的国产材料供应商陆续通过认证并实现批量供货，营业收入和利润规模稳步增长。2026年上半年，半导体设备板块27家样本企业实现营业收入566.88亿元、净利润134.70亿元，同比分别增长31.06%和93.22%；半导体材料板块29家样本企业实现营业收入332.91亿元、净利润16.60亿元，同比分别增长30.45%和49.57%；但受新产品导入期成本较高、折旧摊销压力较大以及市场竞争激烈等因素影响，毛利率水平相较于上年末略有下降，整体仍处于“量增利稳”的爬坡阶段。**芯片设计与晶圆制造**两大板块受存储芯片超预期上行周期驱动，整体盈利表现显著增长。2026年上半年，样本企业内90家芯片设计企业和22家晶圆制造企业合计实现营业收入4,747.11亿元，同比增长98.78%，合计实现净利润1,749.76亿元，同比增长1,686.65%，平均毛利率由上年同期25.97%提升至51.41%。从盈利贡献结构来看，长鑫科技、江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新等存储类设计及制造头部企业贡献了板块的主要增量，其营业收入同比增速普遍超过130%，毛利率同比提升幅度普遍超过25个百分点，净利润普遍实现扭亏为盈或数倍增长；其次，海光信息、寒武纪等国产AI芯片企业受益于国内AI算力建设需求持续旺盛以及国产化替代进程加速，延续较高景气水平，营业收入和净利润持续增长；但中诚信国际关注到，受下游需求疲软、行业竞争加剧及晶圆制造环节折旧压力较大等因素影响，2026年上半年样本芯片设计和晶圆制造企业中仍有约23%处于亏损状态，且主要集中于射频、消费电子等通用类芯片领域，板块内盈利改善的结构性分化特征依然显著。**分立器件板块**营业收入同比大幅下降，主要受*ST闻泰营业收入下滑拖累影响。剔除该扰动因素后，其余17家样本企业2026年上半年营业收入同比增长23.46%，净利润同比增长21.77%，实际呈现复苏态势，细分领域结构亦有所分化，一方面传统消费电子、家电等下游需求疲软，中低端MOSFET、二极管等产品价格竞争激烈；另一方面新能源汽车、光伏储能、工业控制等下游需求保持增长，带动IGBT、碳化硅、光芯片等高附加值产品量价齐升。



数据来源：Choice，中诚信国际整理

资产质量方面，2026年上半年，受益于盈利能力大幅改善和外部融资补充，样本企业合计货币资金储备有所增加，整体回款效率明显提升，财务杠杆水平有所下降，但存货周转率呈结构性分化，资产质量总体向好。**资产结构方面**，受益于经营活动净现金流的改善以及股权、债权融资的共同推动，2026年6月末样本企业货币资金合计5,775.84亿元，同比增长54.47%，货币资金占总资产比重同比增至20.98%。同期末，样本企业存货合计3,904.43亿元，同比增长40.77%，但存货周转率存在一定分化，其中半导体材料板块受益于国产替代进入批量供货阶段，存货周转率有所改善，芯片设计与晶圆制造板块受产能扩张、战略性备货等因素影响，存货周转效率有所下降。此

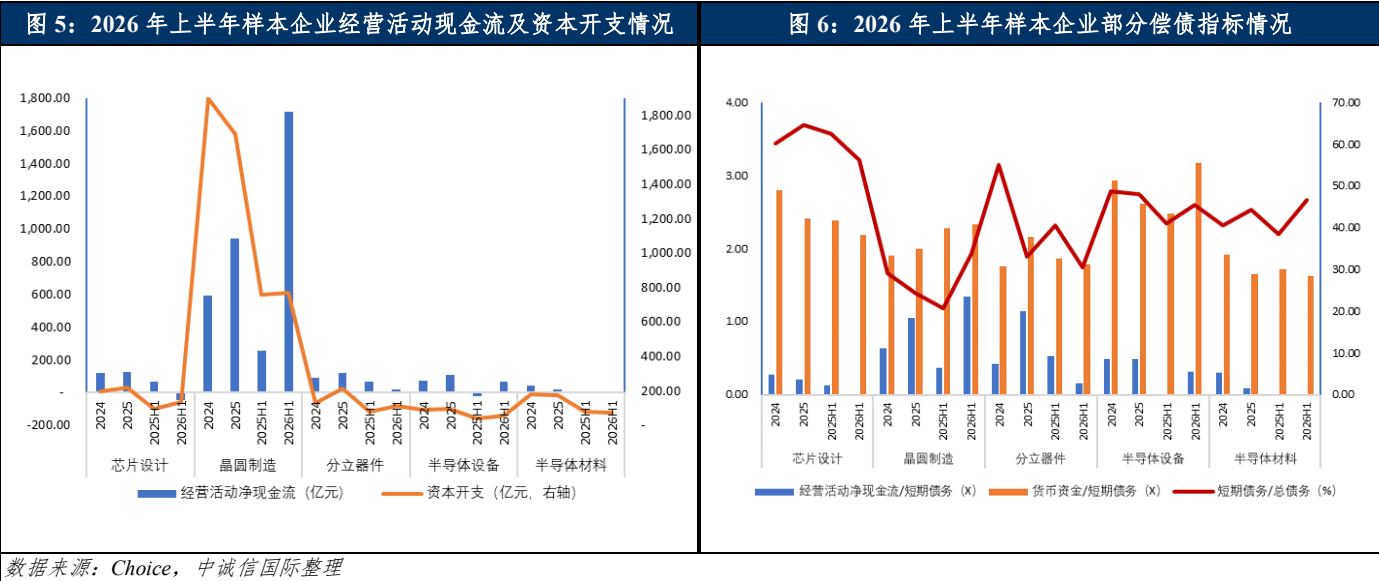
外，样本企业整体回款效率明显提升，各板块应收账款周转率均实现不同程度增加。截至2026年6月末，样本企业总债务合计6,356.68亿元，同比增长19.91%，增速慢于总资产和所有者权益增速；所有者权益合计17,312.40亿元，同比增长31.55%，主要系上半年净利润大幅增长以及部分企业股权融资落地所致；资产负债率为37.13%，较上年末下降1.27个百分点，总资本化比率为26.86%，较上年末下降1.72个百分点。整体杠杆水平有所回落，财务稳健性增强。



现金流方面，2026年上半年样本企业经营活动净现金流合计1,745.39亿元，同比大幅增长384.23%，其中芯片设计及晶圆制造板块增幅最大，主要受长鑫科技业务规模大幅增长带动，其余样本企业经营性现金流整体稳中向好；半导体设备板块经营活动净现金流由负转正，标志着国产设备企业从“投入期”逐步进入“收获期”；但分立器件和半导体材料板块现金流情况相对承压。**投资活动方面**，2026年上半年样本企业资本开支合计1,149.67亿元，同比增长9.95%，扩张节奏整体温和，其中半导体材料板块在前两年产能扩张后进入消化期，叠加市场竞争激烈，新增投资趋于谨慎，资本开支小幅回落，其余各板块均实现不同程度增长。半导体设备和分立器件板块企业资本开支基数较小且增速最快，分别同比增长50.92%和42.62%，前者用于应对国产替代订单增长的产能扩张，后者逆势加大IGBT、碳化硅等高端产能投入以布局下一轮上行周期。芯片设计及晶圆制造板块企业资本开支规模基数较大，处于稳步扩张阶段。

债权融资方面，样本企业仍以银行融资为主，但债券融资渠道正持续拓宽。自债券市场“科创板”推出以来，2026年政策支持持续加码，上交所1月修订专项品种公司债券指引、交易商协会3月从五大维度优化科创债机制、江苏四川等地相继出台贴息和补贴政策，形成中央与地方政策协同发力格局，带动科创债发行规模持续扩容，为半导体企业提供了新的融资渠道。2026年上半年，样本企业债券发行明显提速，新发行债券13只，合计发行规模141.93亿元，占存续债券发行规模的33.93%。从债券类型看，可转换债券凭借股债结合的产品特性以及低票面利率的优势，仍是存续债券中发行规模占比最高的品种，截至2026年6月末，样本企业存续可转换债券共20只，债券余额243.41亿元，占存续债券余额比重为60.47%。与此同时，科创债已成为2026年上半年新增债券的重要增长点，上半年样本企业新发行的非可转换债券中，多数标注“科创债”或“科创票据”标签，且发行利率显著低于普通信用债，反映2026年以来半导体企业对科创债融资工具的接受度和使用频率快速提升。**偿债能力方面**，2026年上半年，样本企业短期债务占总债务的比重由上年同期的31.43%增长至40.02%，提升8.59个百分点，但由于货币资金规模增速较快，样本企业货币资金对短期债务的覆盖能力略有提升，短期债务保障程度仍处于较好水平。同时，受益于经营获现能力的提升，经营活动净现金流与短期债务的比值亦有所增长，整体偿债能力有所改善，短期偿债压

力可控。



三、结论

2026年上半年，在海内外政策双向作用与AI算力需求爆发的共同驱动下，中国半导体行业呈现结构性高景气格局。海外限制措施持续收紧对国内先进制程及国际化业务布局形成外部约束，而国内中央与地方构建的多维度产业扶持体系，则为国产替代和自主可控提供了有力政策支撑。在此背景下，设备、材料领域国产替代进程加速，替代深度与广度同步拓展，但高端环节仍存在明显短板；AI芯片与存储芯片供需紧张，成为行业利润增长的核心引擎；终端需求分化显著，AI相关产品量价齐升，汽车电子与工控保持稳健，消费电子仍处于复苏调整周期。行业内样本企业整体盈利水平大幅跃升，资产质量总体向好，经营活动现金流有所好转，偿债指标表现有所改善，但内部细分领域亦分化显著。展望未来，预计全年AI算力需求仍处于上升通道，行业高景气度有望延续，但仍需警惕地缘政治与出口管制引发的供应链扰动风险，以及成熟制程、消费类芯片等传统赛道面临的市场竞争压力。

附表一：2026年以来中国半导体行业国内主要政策梳理

时间	政策发布方	文件名称	主要内容
国家层面政策			
2025.12	工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委、教育部、商务部、国务院国资委、市场监管总局、国家数据局	《"人工智能+制造"专项行动实施意见》（工信部联科〔2025〕279号）	到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，推出1000个高水平工业智能体，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。
2026.4	工业和信息化部、国家数据局	《关于联合实施2026年“模数共振”行动的通知》	重点面向钢铁、石化化工、有色金属、建材、工业母机、汽车、医疗装备、电力装备、船舶、航空航天、家居、医药、生物制造、历史经典、电子元器件、消费电子、新型显示、软件、信息通信、网络安全等行业或领域，通过行动牵引，推动产出一批推广价值高、技术可行性强的人工智能应用场景，攻关一批蕴含工业和信息化领域技术机理的行业模型、专用模型和特色智能体，构建一批行业通识和行业专识高质量数据集，培育一批攻关联合体，优化人才、标准等产业配套生态。到2026年底，基本形成“数据-模型-场景应用”良性互促的循环，推动人工智能高水平赋能新型工业化。
2026.4	国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局	《关于做好2026年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》	部署2026年享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，按技术线宽分档覆盖集成电路全产业链各类主体，明确准入标准以精准落实产业税收扶持政策。
2026.9	工业和信息化部、国家发展改革委	《电子信息制造业发展“十五五”规划》	围绕“筑基、提质、育新、治理”四大方向部署17项重点任务，聚焦集成电路全链条攻关、先进计算生态构建等核心领域，明确到2030年规模以上企业营业收入突破30万亿元的发展目标。
地方层面政策			
2026.1	上海市	《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026-2028年）》	支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，推动高性能智算芯片加快发展。
2026.1	广州市	《广州市南沙区促进半导体与集成电路产业高质量发展扶持办法》（穗南府办规〔2026〕2号）	聚焦第三代半导体特色产业集群，对制造项目按设备投入10%给予最高2亿元补贴，流片最高配套150万元，EDA/IP最高补贴300万元，测试验证最高300万元，贷款贴息最高500万元，覆盖全产业链十个扶持方向。
2026.3	深圳市	《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026-2028年）》	支持国产GPU、NPU、CPU、DPU等核心芯片迭代，鼓励RISC-V高性能计算芯片研发，支持第三代半导体功率器件研发与应用。
2026.8	北京市	《AI4Chip人工智能赋能集成电路产业跨越式发展行动计划（2026-2028年）》	全国首个AI赋能集成电路专项政策，计划培育3-5家国际影响力的AI4Chip生态领军企业，打造10个以上标杆应用，推动AI在芯片全环节深度融合

资料来源：中诚信国际根据公开资料整理

附表二：2026年以来各国对中国半导体行业主要限制措施

时间	国家	主要措施
2025.12	美国	美国贸易代表办公室就对华半导体 301 调查发布《行动通知》，认定中国在半导体领域的相关做法、政策与行为构成可采取行动的情形，决定对中国半导体产品加征 301 关税；关税以 0% 的初始税率启动，并规定 18 个月后（2027 年 6 月 23 日）起提高税率，过渡期内暂不加征。
2026.1	美国	美国商务部工业与安全局修订对华先进计算芯片出口许可审查政策，将英伟达 H200、AMD MI325X 等同级别高性能 AI 芯片的对华出口由“推定拒绝”调整为“逐案审批”；申请须同时满足产品在美国商业渠道可购、出口不减少对美国客户的全球产能、中国买方已建立出口合规程序、产品经美国第三方独立测试验证等条件，符合条件者可获批出口。
2026.1	美国	美国总统发布第 11002 号公告，依据《1962 年贸易扩展法》第 232 条，对特定先进计算芯片（含英伟达 H200、AMD MI325X）及其衍生品加征 25% 从价关税；用于美国数据中心、研发活动及维修替换等用途的进口可获豁免，同时保留第二阶段更广泛关税及关税抵免安排。
2026.6	美国	美国国防部发布 1260H “中国军事企业”清单更新，将半导体等战略产业领域的多家中国企业列入，其中包括中芯国际（SMIC）的多家子公司；被列入实体将受美国国防采购限制，并触发相关投资限制。
2026.8	美国	美国总统发布第 11052 号公告，依据第 232 条对多晶硅及其衍生品（含硅锭、晶圆等）设定最低进口价格，并加征 15% 从价关税，同时配套“回流美国”生产激励计划；该措施针对半导体上游材料环节，于 2026 年 12 月 4 日生效。
2026.9	韩国	韩国产业通商资源部修订版《战略物资进出口公告》正式生效，新增高性能 AI 集成电路（3A501.a.16，总处理性能≥6000）以及半导体光刻、蚀刻、薄膜沉积等先进制造设备（3B501.a~n）等物项，出口上述物项须事先取得许可并强化最终用户与最终用途审查；此次修订同步纳入瓦森纳安排、澳大利亚集团、核供应国集团与导弹技术控制制度共 80 余项修订，使韩国管制清单与美、欧、日规则进一步接轨。
2026.9	欧盟	欧盟委员会通过授权条例 C(2026)6323，以新文本整体替换《欧盟两用物项条例》(EU)2021/821 附件一管制清单，新增半导体制造与测试设备及材料（如钼、钽原子层沉积设备，EUV 掩模及掩模版的开发与检测设备，单晶圆清洗设备等）与先进计算集成电路（含数字处理单元的集成电路及组件）等物项，并修改部分管制参数与技术定义，使清单对齐 2025 年瓦森纳安排、澳大利亚集团、核供应国集团的决定及成员国额外承诺；该条例属普遍性清单调整，并非专门针对中国的禁令。

资料来源：中诚信国际根据公开资料整理

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本文件享有完全的著作权。本文件包含的所有信息受法律保护。未经中诚信国际事先书面许可，任何人不得对本文件的任何内容进行复制、拷贝、重构、删改、截取或转售，或为上述目的存储本文件包含的信息。如确实需要使用本文件上的任何信息，应事先获得中诚信国际书面许可，并在使用时注明来源，确切表达原始信息的真实含义。中诚信国际对于任何侵犯本文件著作权的行为，都有权追究法律责任。

本文件上的任何标识、任何用来识别中诚信国际及其业务的图形，都是中诚信国际商标，受到中国商标法的保护。未经中诚信国际事先书面允许，任何人不得对本文件上的任何商标进行修改、复制或者以其他方式使用。中诚信国际对于任何侵犯中诚信国际商标权的行为，都有权追究法律责任。

本文件中包含的信息由中诚信国际从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在信息时效性及其他因素影响，上述信息以提供时状态为准。中诚信国际对于该等信息的准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。在任何情况下，a) 中诚信国际不对任何人或任何实体就中诚信国际或其董事、高级管理人员、雇员、代理人获取、收集、编辑、分析、翻译、交流、发表、提交上述信息过程中造成的任何损失或损害承担任何责任，或 b) 即使中诚信国际事先被通知前述行为可能会造成该等损失，对于任何由使用或不能使用上述信息引起的直接或间接损失，中诚信国际也不承担任何责任。

本文件所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。中诚信国际对上述信用级别、意见或信息的准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的担保。信息中的评级及其他意见只能作为信息使用者投资决策时考虑的一个因素。相应地，投资者购买、持有、出售证券时应该对每一只证券、每一个发行人、保证人、信用支持人做出自己的研究和评估。

	部门	职称
杨 锐	企业评级部	资深分析师
毛楚杰	企业评级部	分析师



中诚信国际信用评级有限责任公司

地址：北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号
银河 SOHO5 号楼

邮编：100010

电话：(86010) 66428877

传真：(86010) 66426100

网址：<http://www.ccxi.com.cn>

CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD

ADD: Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuguan Lane,
Chaoyangmennei Avenue,Dongcheng District, Beijing
PRC,100010Beijing,PRC.100010

TEL: (86010) 66428877

FAX: (86010) 66426100

SITE: <http://www.ccxi.com.cn>